

2024
04/17

化合物半导体材料与测试技术研讨会

Semiconductor Compound Materials and Testing Technology Seminar

在电动车与新能源市场需求下，化合物半导体材料如碳化硅 (SiC) 和氮化镓 (GaN) 具高频率、耐高压、优异的散热性能和高效能转换，成为车用半导体、电源管理IC的关键技术。新型半导体材料如氧化镓 (Ga₂O₃)、石墨烯等，具特殊电子性能，有望在未来电子器件发挥作用。在晶圆制造、检测分析如：材料分析 (MA)、故障分析 (FA) 及车用半导体测试，有效掌握从研发到量产的制程。

面对高效能运算和AI趋势，先进封装包括 3DIC 及硅光子技术，可提高带宽互连能力。硅光子在高速通信和数据传输中具替代传统电子组件潜力，带来高效能、低耗能的数据处理，提高系统整合密度和效率。

筑波科技与美商 Teradyne 合作推广 ETS 解决功率器件和功率模块测试，并利用太赫兹及拉曼检测分析技术，应对非破坏性 Wafer 材料测试、3DIC 高阶封装的测试挑战。诚挚邀请业界先进共同莅临参与。

PM
12:30~13:00 Registration

13:00~13:10 Welcome

13:10~13:30 车用半导体与宽能隙半导体应用市场趋势
Market trend of Automotive & WBG Semiconductor

13:30~14:00 化合物半导体在 Silicon Photonics 及光电异质整合之运用

14:00~14:30 Tip-enhanced Raman Spectroscopy (TERS) with Super Spectral and Spatial Resolution for Noninvasive Analyses

14:30~14:50 化合物半导体Wafer材料测试与挑战

14:50~15:10 Break

15:10~15:40 氮化镓功率晶体管之前瞻应用

15:40~16:10 宽能隙氧化镓电性之研发

16:10~16:40 车载功率模块测试解决方案

16:40~17:00 3DIC 高阶封装的非破坏性测试新里程碑

17:00~17:30 方案展示交流 Solution Showcase

A: IGBT 功能测试展示

B: 化合物半导体 Wafer 及材料非破坏性测试展示

C: 车用半导体租赁方案：优势与挑战

17:30~17:40 Q & A

Raymond Kao, GM, Teradyne
高士卿台湾区总经理, 泰瑞达

Steve Hsu, President, ACE
许深福董事长, 筑波科技

Jason Hsieh, ACE
谢易铮, 筑波科技 业务项目经理

SEMI Taiwan
Prof. Hao-Chung Kuo
Department of Photonics, NYCU
郭浩中教授, 阳明交大光电工程研究所

Prof. Ta-Jen Yen
Department of Materials Science and Engineering, NTHU
严大任教授兼全球长, 清大材料科学工程学系

Antony Hsu, Project Manager, ACE
许永周, 筑波科技 项目经理

Prof. Wei-Hua Chieng
Department of Mechanical Engineering
成维华教授兼副院长, 阳明交大机械工程系

Prof. Ray-Hua Horng
Institute of Electronics, NYCU
洪瑞华教授, 阳明交大电子研究所

Ramon Liu, Technical Director
Mi Equipment
柳焱佳, 正齐半导体 技术总监

Dr. Harry Kuan, RD Manager, ACE
官晖舜博士, 筑波科技 研发经理

ACE

ACE

ACE

JOIN



时间: 2024年04月17日(三) 13:00-17:30

线上直播 (VIP邀请ONLY)

报名: https://register.acesolution.com.tw/20240417_WBGSemiconductor_Seminar

黄总监 Fred: 18666826750 service@acesolution.com.tw

主办: TERADYNE



筑波网络科技(苏州)有限公司
ACE Technology Corp.

讲师
单位:



國立陽明交通大學
NATIONAL YANG MING CHIAO TUNG UNIVERSITY



Mi
Equipment



黄总监 Fred: 18666826750 service@acesolution.com.tw